

## 静電容量センサマイコン

### 静電容量タッチ ノイズイミュニティガイド

#### 要旨

ルネサスの静電容量タッチセンサユニット（CTSU）は、不要な電気信号(ノイズ)によって生成される静電容量の微小な変化を検出できるため、周囲環境のノイズの影響を受けやすい場合があります。このノイズの影響は、ハードウェアの設計によって異なります。そのため、設計段階で対策を施すことが周囲環境のノイズに強い CTSU マイコンとなり、効果的な製品開発につながります。

本書では、国際規格 IEC61000-4 に定める各イミュニティノイズに対して、CTSU を使用する製品のノイズ耐性を向上する方法を説明します。

#### 動作確認デバイス

CTSU 搭載 RX ファミリ、RA ファミリ、RL78 ファミリ MCU、Renesas Synergy™  
(CTSU、CTSU2、CTSU2L、CTSU2La、CTSU2SL)

#### 本書が対象とする規格

- IEC-61000-4-3
- IEC-61000-4-6

目次

1.	はじめに	3
2.	ノイズの種類と対策	4
2.1	EMC 規格	4
2.2	RF ノイズと対策	5
2.3	ESD ノイズ (Electro-Static Discharge : 静電気放電)	8
2.4	EFT ノイズ (Electrical Fast Transients : 電気的高速過渡現象)	8
3.	CTSU のノイズ対策機能	9
3.1	計測原理とノイズの影響	9
3.2	CTSU1	9
3.2.1	ランダム位相シフト機能	9
3.2.2	高域ノイズ低減機能 (スペクトラム拡散機能)	10
3.3	CTSU2	10
3.3.1	マルチ周波数計測	10
3.3.2	アクティブシールド	11
3.3.3	非計測チャンネル出力選択	11
4.	ハードウェアのノイズ対策	12
4.1	共通のノイズ対策	12
4.1.1	タッチ電極パターン設計	12
4.1.2	電源設計	13
4.1.2.1	電圧供給源の設計	13
4.1.2.2	GND パターン設計	14
4.1.3	未使用端子の処理	14
4.2	放射 RF のノイズ対策	15
4.2.1	TS 端子のダンピング抵抗	15
4.2.2	デジタル信号のノイズ	15
4.2.3	マルチ周波数計測	15
4.3	伝導ノイズ対策	16
4.3.1	コモンモードフィルタ	16
4.3.2	コンデンサの配置	16
4.3.3	マルチ周波数計測	17
4.3.4	GND シールドと電極間距離の考慮	17
5.	ソフトウェアフィルタ	18
5.1	IIR フィルタ	18
5.2	FIR フィルタ	19
5.3	使用例	19
5.4	計測周期の注意事項	19
	改訂記録	21

## 1. はじめに

CTSU はタッチ電極に充電した電流量から静電容量を推定します。計測中にノイズの影響でタッチ電極の電位が変化すると充電電流が変化することで、計測値も影響を受けます。具体的には、計測値に大きな変動があればタッチ閾値を超えて誤動作につながります。計測値への細かな変動は、リニアな計測を必要とするアプリケーションには影響があります。

CTSU の静電容量タッチシステムのノイズ耐性を考えるには、CTSU のタッチ検出動作やボード設計情報の知識が必要です。CTSU を初めてご使用になる場合、まず下記関連ドキュメントを参照し、CTSU や静電容量タッチの理解を深めることを推奨します。

- 静電容量タッチ検出および CTSU の基本情報  
[静電容量センサマイコン 静電容量タッチ導入ガイド \(R30AN0424\)](#)
- ハードウェア・ボード設計に関する情報  
[静電容量センサマイコン 静電容量タッチ電極デザインガイド \(R30AN0389\)](#)
- CTSU ドライバ (CTSU モジュール) ソフトウェアに関する情報  
RA ファミリ [Renesas Flexible Software Package \(FSP\) User's Manual \(Web Version - HTML\)](#)  
API Reference > Modules > CapTouch > [CTSU \(r\\_ctsu\)](#)  
RL78 ファミリ [CTSU モジュール Software Integration System \(R11AN0484\)](#)  
RX ファミリ [QE CTSU モジュール Firmware Integration Technology \(R01AN4469\)](#)
- Touch ミドルウェア (TOUCH モジュール) ソフトウェアに関する情報  
RA ファミリ [Renesas Flexible Software Package \(FSP\) User's Manual \(Web Version - HTML\)](#)  
API Reference > Modules > CapTouch > [Touch \(rm\\_touch\)](#)  
RL78 ファミリ [TOUCH モジュール Software Integration System \(R11AN0485\)](#)  
RX ファミリ [QE Touch モジュール Firmware Integration Technology \(R01AN4470\)](#)
- 静電容量タッチアプリケーション開発支援ツール QE for Capacitive Touch に関する情報  
[RA ファミリ QE と FSP を使用した静電容量タッチアプリケーションの開発\(R01AN4934\)](#)  
[RX ファミリ QE と FIT を使用した静電容量タッチアプリケーションの開発\(R01AN4516\)](#)  
[RL78 ファミリ QE と SIS を使用した静電容量タッチアプリケーションの開発\(R01AN5512\)](#)  
[RL78 ファミリ スタンドアロン版 QE を使用した静電容量タッチアプリケーションの開発 \(R01AN6574\)](#)  
[静電容量センサマイコン QE for Capacitive Touch アドバンスドモード\(高度な設定\)パラメータガイド\(R30AN0428\)](#)

## 2. ノイズの種類と対策

### 2.1 EMC 規格

表 2-1 に EMC 規格の一例を示します。ノイズは空間や接続ケーブルを伝播してシステムに侵入し動作に影響を及ぼします。ここでは CTSU を使用したシステムを正常に動作させるために注意すべきノイズ種類として IEC61000 で例に示します。IEC61000 の詳細については、最新の規格をご確認ください。

表 2-1 EMC 規格の一例 (IEC61000)

試験内容	概要	規格
放射イミュニティ試験	比較的高周波の RF ノイズに対する耐性のテスト	IEC61000-4-3
伝導イミュニティ試験	比較的低周波の RF ノイズに対する耐性のテスト	IEC61000-4-6
静電気放電試験 (ESD)	静電気放電に対する耐性のテスト	IEC61000-4-2
電氣的ファストトランジェント/ バースト試験 (EFT/B)	電源ライン等に混入する連続的なパルス状過渡応答ノイズに対する耐性のテスト	IEC61000-4-4

表 2-2 にイミュニティ試験の性能基準を示します。EMC のイミュニティ試験には性能基準が規定されており、試験時の装置の動作から判定を行います。性能基準は各規格に対して共通です。

表 2-2 イミュニティ試験の性能基準

性能基準 (Performance Criterion)	概要
A	装置は、試験中および試験後も意図したとおりに動作し続けるものとします。 機器が意図したとおりに使用されている場合、メーカーが指定した性能レベルを下回る性能の低下または機能の損失は許容されません
B	装置は、試験後も意図したとおりに動作し続けるものとします。 装置が意図したとおりに使用されている場合、メーカーが指定した性能レベルを下回る性能の低下または機能の損失は許されません。ただし、テスト中の性能の低下は許容されます。実際の動作状態や保存データの変化は許容されません。
C	機能が自己回復可能であるか、制御部の操作によって回復できる場合、一時的な機能の喪失は許容されます。

## 2.2 RF ノイズと対策

RF ノイズはテレビ・ラジオ放送・携帯端末などで使用される無線周波の電磁波です。RF ノイズは直接基板パターンに入り込むこともあれば、電源などのケーブルから入り込む場合もあります。前者は基板内で、後者は電源などシステムレベルでノイズ対策が必要です。静電容量タッチシステムは静電容量を電気信号に変換して計測します。タッチによる静電容量の変化は微小であり、正常なタッチ検出のためにはセンサ端子やセンサ自体の電源を RF ノイズから保護する必要があります。

RF ノイズ耐性をテストするために IEC61000-4-3 および IEC61000-4-6 があり、2 つの試験規格は試験周波数帯域が異なります。

IEC61000-4-3 は放射イミュニティ試験で、規定された周波数範囲の電波を EUT に直接印加してノイズ耐性を評価します。電波の周波数は 80MHz から 1GHz 以上で、波長に変換すると約 3.7m~30cm です。この波長の長さは基板パターン長に近く、パターンがアンテナとなり CTSU の計測結果に影響する場合があります。またタッチ電極ごとに配線長や寄生容量が異なると影響を与える周波数が端子ごとに異なる場合があります。表 2-3 に放射イミュニティ試験の内容を示します。

表 2-3 放射イミュニティ試験内容

周波数範囲	試験レベル	試験電界強度
80MHz-1GHz 試験バージョンにより、 ~2.7GHz や~6.0GHz	1	1 V/m
	2	3 V/m
	3	10 V/m
	4	30 V/m
	X	個別に規定

IEC61000-4-6 は伝導イミュニティ試験で、放射イミュニティ試験より低い周波数の 150kHz から 80MHz を評価します。この周波数帯域は波長が数 m 以上となり、150kHz の波長は約 2km に及びます。この波長の電波を EUT に直接印加することは難しいため、試験装置により接続されたケーブルに試験信号を印加させ低周波電波の影響を試験します。波長の長さから主に電源や信号のケーブル類に影響します。例えば電源ケーブルがノイズの影響を受け電源電圧が不安定になる周波数帯域があると、CTSU の計測結果が端子一律でノイズの影響を受ける場合があります。表 2-4 に伝導イミュニティ試験の内容を示します。

表 2-4 伝導イミュニティ試験内容

周波数範囲	試験レベル	試験強度
150kHz-80MHz	1	1 V rms
	2	3 V rms
	3	10 V rms
	X	個別に規定

システムの GND や MCU の VSS 端子が商用電源のアース端子に接続されていない AC 電源設計では伝導ノイズが直接基板にコモンモードノイズとして侵入し、ボタンタッチ時の CTSU 計測結果にノイズが発生することがあります。

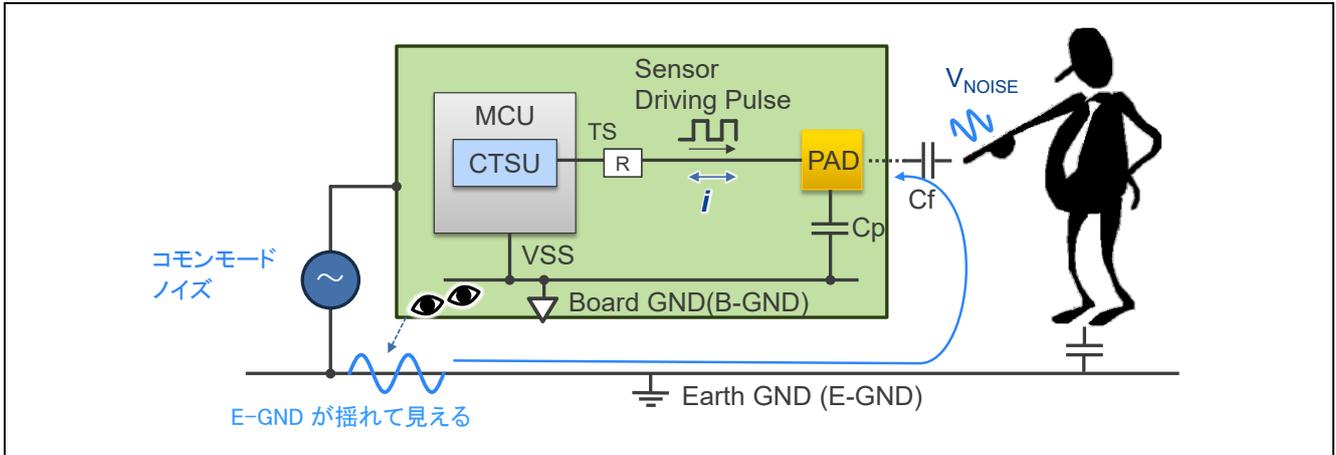


図 2-1 コモンモードノイズの侵入経路

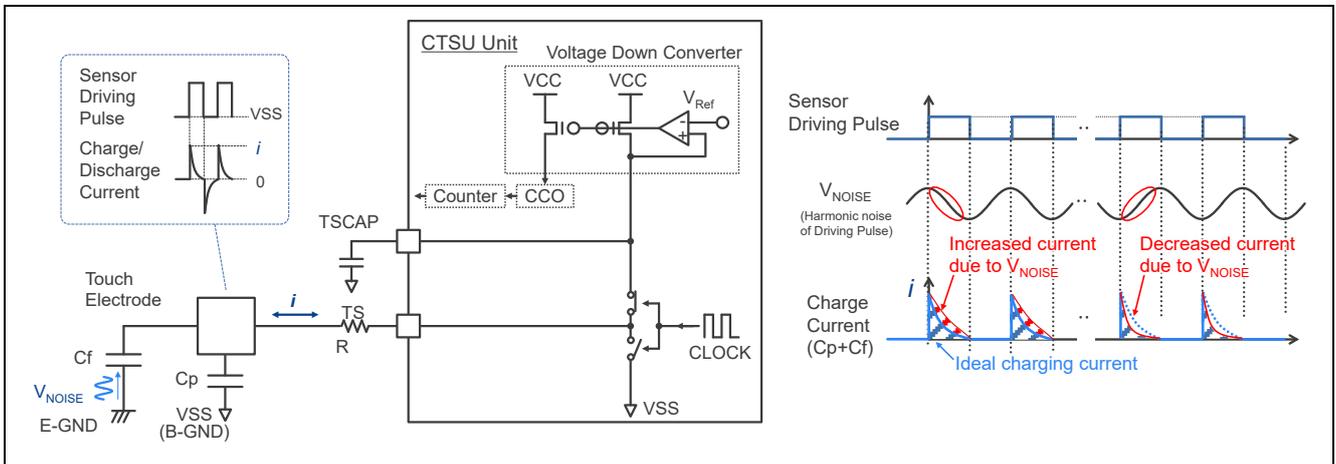


図 2-2 コモンモードノイズと計測電流の関係

図 2-1 にコモンモードノイズの侵入経路、図 2-2 にコモンモードノイズと計測電流の関係を示します。コモンモードノイズは Board GND (B-GND) から見ると Earth GND (E-GND) にノイズが重畳して変動しているように見え、タッチ電極 (PAD) に触れる人体も浮遊容量により E-GND と結合しているためコモンモードノイズが伝わり E-GND と同様に変動しているように見えます。

ここで PAD に触れると、指と PAD で形成された静電容量  $C_f$  にコモンモードノイズをノイズ源とするノイズ ( $V_{NOISE}$ ) が印加され、CTSU で計測する充電電流が変動します。充電電流の変化に追従した計測結果はノイズが重畳したデジタル値に現れます。コモンモードノイズに CTSU のドライブパルス周波数とその高調波に一致する周波数成分が含まれる場合に計測結果の変動が大きくなる場合があります。

表 2-5 に RF ノイズ耐性を向上させるために必要な対策の一覧を示します。放射イミュニティ耐性と伝導イミュニティ耐性への要件はほとんどが共通します。各項目の詳細は掲載章記載の項目を参照してください。

表 2-5 RF ノイズ耐性を向上させるために必要な対策の一覧

開発ステップ	設計時に必要な対策	掲載章
MCU 選定 (CTSU 機能選択)	<p>ノイズ耐性を重視する場合、CTSU2 搭載 MCU を推奨します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● CTSU2 のノイズ対策機能を有効にする                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— マルチ周波数計測</li> <li>— アクティブシールド</li> <li>— アクティブシールドを配置する場合、非計測チャネルの出力を設定する</li> </ul> </li> </ul> <p>または</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● CTSU のノイズ対策機能を有効にする                             <ul style="list-style-type: none"> <li>— ランダム位相シフト機能</li> <li>— 高域ノイズ低減機能</li> </ul> </li> </ul>	<p>3.3.1 マルチ周波数計測</p> <p>3.3.2 アクティブシールド</p> <p>3.3.3 非計測チャネル出力選択</p> <p>3.2.1 ランダム位相シフト機能</p> <p>3.2.2 高域ノイズ低減機能 (スペクトラム拡散機能)</p>
ハードウェア設計	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 推奨電極パターンでのボード設計</li> <li>● 低ノイズの電源供給源を使用する</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● GND パターン設計に配慮する。アース接続するシステムではコモンモードノイズ対策部品の使用を推奨。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ダンピング抵抗値調整によるセンサ端子の侵入ノイズレベル低減</li> <li>● 通信ラインのダンピング抵抗配置</li> <li>● MCU 電源ラインの適切なコンデンサ容量設計、配置</li> </ul>	<p>4.1.1 タッチ電極パターン設計</p> <p>4.1.2.1 電圧供給源の設計</p> <p>4.1.2.2 GND パターン設計</p> <p>4.3.1 コモンモードフィルタ</p> <p>4.3.4 GND シールドと電極間距離の考慮</p> <p>4.2.1 TS 端子のダンピング抵抗</p> <p>4.2.2 デジタル信号のノイズ</p> <p>4.3.2 コンデンサの配置</p>
ソフトウェア実装	<p>ソフトウェアフィルタ調整による計測値ノイズ低減</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● IIR 移動平均 (ランダムノイズ向け、おおよその場合に対応)</li> <li>● FIR 移動平均 (特定の周期ノイズがある場合)</li> </ul>	<p>5.1 IIR フィルタ</p> <p>5.2 FIR フィルタ</p>

### 2.3 ESD ノイズ (Electro-Static Discharge : 静電気放電)

静電気放電は帯電した物体同士が接触や接近したときに発生します。人体に溜まった静電気はオーバーレイを介していても電極に届くことがあります。電極に加えられた静電気のエネルギーの大きさによって CTSU の計測結果へ影響を与え、デバイス自体が破壊される可能性もあります。このため、基板回路上の保護デバイスや、オーバーレイや製品筐体の形状などのシステムレベルでの対策が必要です。

ESD 耐性をテストするためには IEC61000-4-2 規格があります。表 2-6 に ESD 試験の内容を示します。求められる試験レベルは製品の用途・性質によって決まります。詳細は最新の IEC61000-4-2 の規格を確認してください。タッチ電極への ESD は瞬間的に数 kV の電位差が発生するため CTSU の計測においては計測値にパルスノイズが発生による計測精度低下、過電圧や過電流検出により計測停止する場合があります。なお、半導体デバイスは直接 ESD を印加させることを前提としていません。そのため、試験は基板を保護する筐体を含んだ最終製品として実施します。基板内での対策は万入り込んだ ESD から回路を保護するためであり、フェールセーフ的な処置です。

表 2-6 ESD 試験内容

試験レベル	試験電圧	
	接触放電	気中放電
1	2 kV	2 kV
2	4 kV	4 kV
3	6 kV	8 kV
4	8 kV	15 kV
X	個別に規定	個別に規定

### 2.4 EFT ノイズ (Electrical Fast Transients : 電気的高速過渡現象)

電気製品は電源スイッチ操作をしたときの電源内部の構成による逆起電力や、リレースイッチのチャタリングノイズのような電気的な高速過渡現象 (Electrical Fast Transients : EFT) が発生します。電源タップのように複数の電気製品が接続されている環境では、このノイズが電源線を伝い他の電気製品の動作に影響を与える場合があります。タップに電源を接続していない電気製品の電源線や信号線でも、ノイズ源の電源・信号線と近接する場合に空間を伝わり影響を受けることもあります。

EFT 耐性をテストするためには IEC61000-4-4 規格があります。IEC61000-4-4 は、EUT の電源線や信号線に周期的な EFT 信号を注入し耐性を評価します。EFT ノイズにより CTSU の計測結果には周期的なパルスノイズが発生し、計測結果の精度低下やタッチの誤検出が発生する場合があります。表 2-7 に EFT/B 試験の内容を示します。

表 2-7 EFT/B 試験の内容

試験レベル	開回路試験電圧 (ピーク)		パルスの繰り返し周期
	電源線・接地線	信号・制御線	
1	0.5 kV	0.25 kV	5kHz または 100kHz
2	1 kV	0.5 kV	
3	2 kV	1 kV	
4	4 kV	2 kV	
X	個別に規定		個別に規定

### 3. CTSU のノイズ対策機能

CTSU にはノイズ対策機能が実装されていますが CTSU のバージョンにより使用できる機能が異なるため、ご使用になる MCU と CTSU バージョンをご確認ください。本章では CTSU のバージョンによるノイズ対策機能の違いを説明します。

#### 3.1 計測原理とノイズの影響

CTSU は 1 回の計測トリガで複数回充放電を繰り返し、充放電ごとの計測結果を積算することで最終的な計測結果をレジスタに格納します。この計測方式はドライブパルス周波数が高いほど単位時間あたりの計測を増やすことができるためダイナミックレンジ (DR) が向上し、CTSU の高感度計測を実現しています。一方、外来ノイズによりセンサ端子の充放電電流が変化し、周期ノイズが発生する環境では一方向へ電流量の増加または減少によりカウンタレジスタに格納される計測結果がオフセットするなど計測精度が低下する場合があります。

図 3-1 に周期ノイズによる充電電流誤差発生イメージを示します。周期ノイズとして影響する周波数はセンサドライブパルス周波数とその高調波に一致する周波数であり、周期ノイズの立ち上がりまたは立ち下がりが SW1 の ON 期間に同期すると計測値誤差が最大になります。CTSU はこのような周期ノイズ対策としてハードウェアレベルの対策機能を内蔵しています。

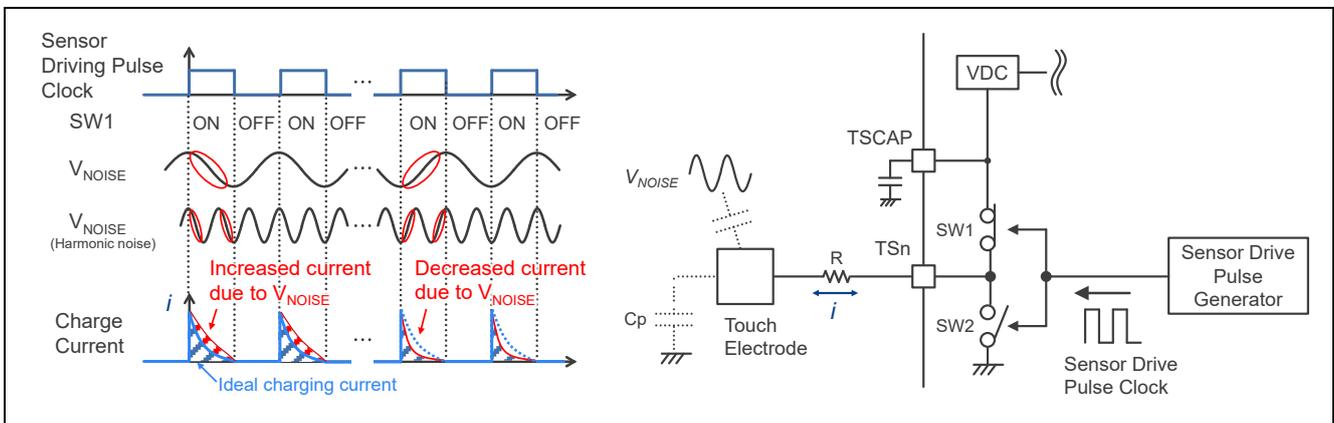


図 3-1 周期ノイズによる充電電流誤差発生イメージ

#### 3.2 CTSU1

CTSU1 は「ランダム位相シフト機能」および「高域ノイズ低減機能 (スペクトラム拡散機能)」を内蔵しています。センサドライブパルス周波数とノイズ周波数の基本周波数が一致した場合の計測値への影響を低減できます。センサドライブパルス周波数の最大設定値は 4.0MHz です。

##### 3.2.1 ランダム位相シフト機能

図 3-2 にランダム位相シフト機能の周期ノイズ非同期化イメージを示します。センサドライブパルスの位相をランダムタイミングで 180 度変えることで、周期ノイズによる一方向への一方的な電流量増減をランダム化し平滑化することで計測精度を改善します。本機能は CTSU モジュールおよび TOUCH モジュールでは常に有効です。

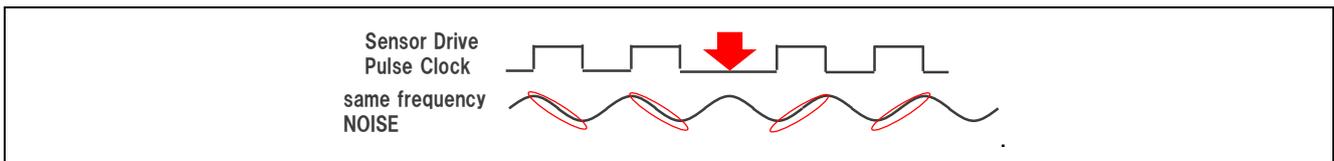


図 3-2 ランダム位相シフト機能の周期ノイズ非同期化イメージ

### 3.2.2 高域ノイズ低減機能（スペクトラム拡散機能）

高域ノイズ低減機能は意図的にジッターを付加したセンサドライブパルス周波数で計測を行い、同期ノイズとの同期点をランダム化することで計測誤差のピーク点を分散し計測精度を改善します。本機能は CTSU モジュールおよび TOUCH モジュールでは常に有効です。

## 3.3 CTSU2

### 3.3.1 マルチ周波数計測

マルチ周波数計測は周波数の異なる複数のセンサドライブパルス周波数を使用して計測します。各ドライブパルス周波数での干渉を避けるためスペクトラム拡散は使用されません。

本機能はセンサドライブパルス周波数の同期ノイズだけでなく、タッチ電極パターンから侵入したノイズに対しても効果があるため伝導 RF ノイズと放射 RF ノイズの耐性が向上します。

図 3-3 にマルチ周波数計測の計測値選択イメージ、図 3-4 にマルチ周波数計測のノイズ周波数分離イメージを示します。マルチ周波数計測では複数周波数で計測した結果のうち、ノイズの影響を受けた計測結果を除外することで計測精度を向上させます。

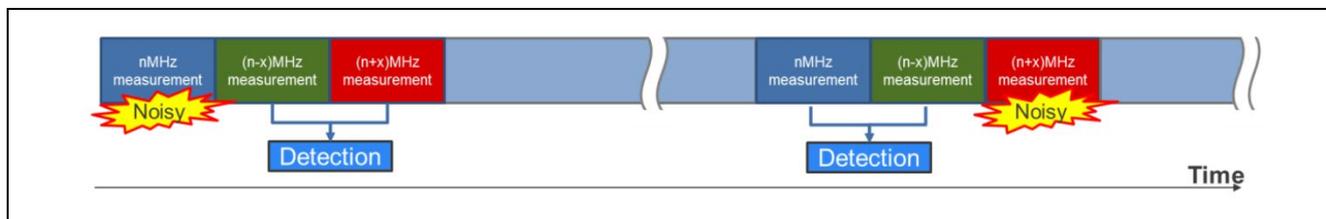


図 3-3 マルチ周波数計測の計測値選択イメージ

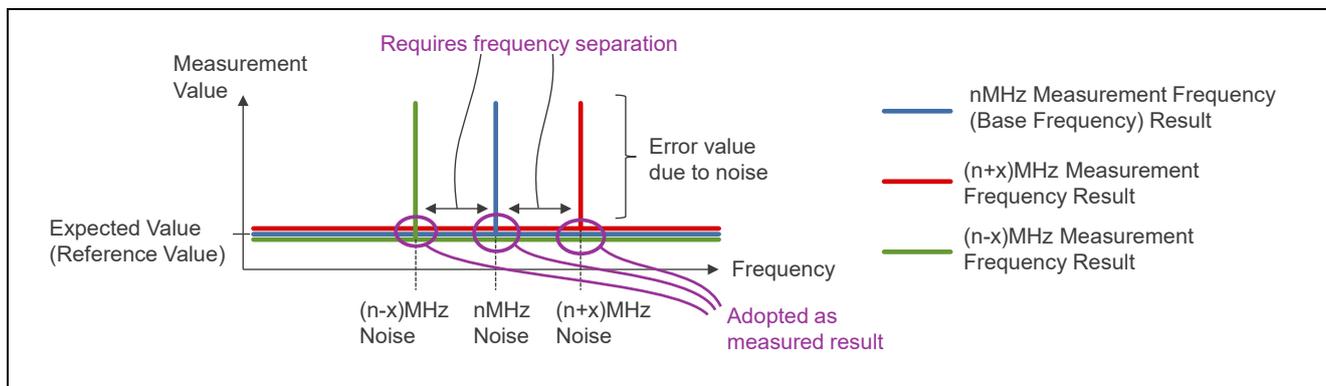


図 3-4 マルチ周波数計測のノイズ周波数分離イメージ

CTSU モジュールと TOUCH モジュールを組み込んだアプリケーションプロジェクト（詳細は FSP、FIT、SIS のドキュメントを参照してください）では、QE for Capacitive Touch の調整フェーズを実行するとマルチ周波数計測のパラメータが自動的に生成され、マルチ周波数計測を使用できます。

調整フェーズの高度な設定（アドバンスドモード）を有効にするとパラメータを手動設定できるようになります。アドバンスドモードのマルチクロック計測設定詳細は「[静電容量センサマイコン QE for Capacitive Touch アドバンスドモード\(高度な設定\)パラメータガイド \(R30AN0428\)](#)」を参照してください。

図 3-5 にマルチ周波数計測の干渉周波数例を示します。本例は計測周波数を 1MHz に設定し、タッチ電極にタッチした状態でボードに共通モードの伝導ノイズを印加した場合に現れる干渉周波数を示します。(a)は自動調整直後の設定で、計測周波数は第 1 周波数の 1MHz を基準に第 2 周波数は+12.5%、第 3 周波数は-12.5%に設定されています。各々の計測周波数がノイズとして干渉していることが確認できます。(b)は測周波数の通倍比を手動調整し、計測周波数を第 1 周波数の 1MHz を基準に第 2 周波数を-20.3%、第 3 周波数を+9.4%に設定した例です。手動調整により第 2、第 3 周波数の干渉周波数が変化したことを確認できます。特定の周波数ノイズが計測結果に現れる場合、計測周波数と一致する周波数のノイズであれば、ノイズ周波数と計測周波数が干渉しないように実環境にて評価を行いながらマルチ周波数計測を調整してください。

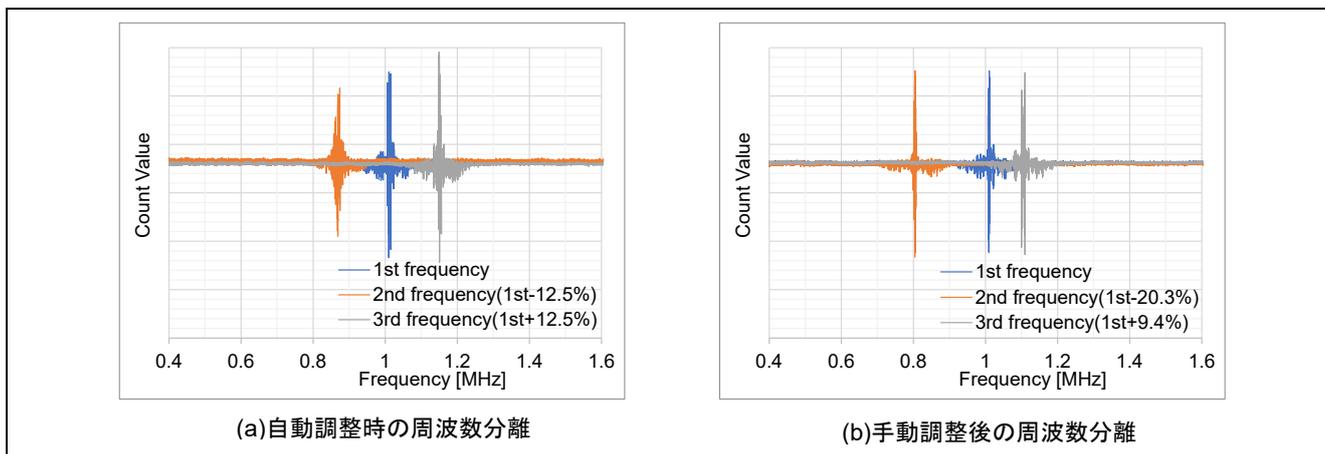


図 3-5 マルチ周波数計測の干渉周波数例

### 3.3.2 アクティブシールド

CTSU2 の自己容量方式では、シールドパターンをセンサドライブパルスと同相のパルスで駆動するアクティブシールドとして設定できます。アクティブシールドを有効にするには、QE for Capacitive Touch のインタフェース構成でアクティブシールドパターンを接続した端子を「シールド端子」として設定してください。アクティブシールドはタッチインタフェース構成（メソッド）につき 1 端子設定できます。アクティブシールドの動作説明は[静電容量センサマイコン 静電容量タッチ導入ガイド \(R30AN0424\)](#)を参照してください。設計情報は[静電容量センサマイコン 静電容量タッチ電極デザインガイド \(R30AN0389\)](#)を参照してください。

### 3.3.3 非計測チャンネル出力選択

CTSU2 の自己容量方式では、非計測チャンネルの出力としてセンサドライブパルスと同相のパルス出力を設定できます。QE for Capacitive Touch のインタフェース構成（メソッド）で、アクティブシールドが割り当てられたメソッドの非計測タッチ電極は自動的に同相パルス出力設定になります。

## 4. ハードウェアのノイズ対策

### 4.1 共通のノイズ対策

#### 4.1.1 タッチ電極パターン設計

タッチ電極回路はノイズを受けやすく、ハードウェア設計段階でノイズ耐性を考慮する必要があります。ノイズ耐性を考慮した基板設計ルールの詳細は、最新の [CTSU 静電容量タッチ電極デザインガイド \(R30AN0389\)](#) を参照してください。図 4-1 に自己容量方式のパターン設計要旨抜粋、図 4-2 に相互容量方式のパターン設計要旨抜粋を示します。

- ① 電極形状：正方形または円
- ② 電極サイズ：10mm～15mm
- ③ 電極間隔：指などタッチを想定する物体で同時反応しない間隔（ボタンサイズ×0.8倍以上が目安）
- ④ 配線幅：プリント基板の場合 0.15mm～0.20mm 程度
- ⑤ 配線長：可能な限り短くしてください。コーナーは直角でなく 45 度にしてください。
- ⑥ 配線間隔：(A)電極付近は誤反応防止のため可能な限り離してください。(B)1.27mm ピッチ
- ⑦ メッシュ GND パターンの幅：5mm
- ⑧ メッシュ GND パターンとボタン・配線との間隔  
 (A)電極周辺：5mm、(B)配線周辺：3mm 以上、  
 電極または配線と反対面はメッシュパターンで覆ってください。空き部分もメッシュを配置して、両面のメッシュをビアで接続してください。  
 メッシュパターン寸法、アクティブシールド（CTSU2のみ）など追加のノイズ対策は「2.5 ノイズ対策設計」の項を参照してください。
- ⑨ 電極+配線容量：50pF 以下
- ⑩ 電極+配線抵抗値：2kΩ以下（基準値 560Ωのダンピング抵抗を含む）

図 4-1 自己容量方式のパターン設計要旨抜粋

- ① 電極形状：正方形（送信電極 Tx と受信電極 Rx の組み合わせ）
- ② 電極サイズ：10mm 以上
- ③ 電極間隔：指などタッチを想定する物体で同時反応しない間隔（ボタンサイズ×0.8倍以上が目安）
- ④ 配線幅：量産可能な最小線幅、プリント基板の場合 0.15mm～0.20mm 程度
- ⑤ 配線長：可能な限り短くしてください。コーナーは直角でなく 45 度にしてください。
- ⑥ 配線間隔：A：電極付近は誤反応防止のため可能な限り離してください  
 B：電極から離れた場所は 1.27mm ピッチ  
 C：Tx と Rx 間には結合容量が発生しないように 20mm 以上
- ⑦ メッシュ GND パターン（シールドガード）との間隔  
 ボタンの推奨パターンは端子の寄生容量が比較的小さいため GND を近づけ寄生容量を増やします  
 A：電極周辺は 4mm 以上  
 電極間にも 2mm 幅程度のメッシュ GND パターンを推奨します  
 B：配線周辺は 1.27mm 以上
- ⑧ Tx、Rx の寄生容量：20pF 以下
- ⑨ 電極+配線抵抗値：2kΩ以下（基準値 560Ωのダンピング抵抗を含む）
- ⑩ 電極と配線直下には GND パターンを配置しないでください。  
 相互容量方式ではアクティブシールド機能は使用できません。

図 4-2 相互容量方式のパターン設計要旨抜粋

4.1.2 電源設計

CTSU は微小な電気信号を扱うアナログペリフェラル機能です。MCU に供給される電圧や GND パターンにノイズがあるとセンサドライブパルスの電位が変動し計測精度が低下します。計測精度を維持するために電源ラインやオンボード電源回路にノイズ対策デバイスを追加することで、安定した電源を MCU に供給してください。

4.1.2.1 電圧供給源の設計

MCU の電源端子からノイズが侵入しないよう、システムやボード上デバイスの電源設計に注意してください。以下に設計のポイントを示します。

- システムへの給電用ケーブルや配線は可能な限り短くし、インピーダンスを最小化してください。
- 高周波ノイズに対してはノイズフィルタ（フェライトコア、フェライトビーズ）を配置および実装してください。
- MCU 電源のリップルを最小化してください。MCU の電圧供給源にはリニアレギュレータを推奨します。リニアレギュレータは低ノイズ出力、高 PSRR の製品を選定してください。
- ボード上に電流負荷が高いデバイスが複数ある場合、MCU 専用の電源を個別に配置することを推奨します。個別の電源を用意できない場合は電源の根元からパターンを分離してください。
- MCU 端子で高消費電流のデバイスを動作させる場合はトランジスタや FET を使用してください。

図 4-3 に電源供給ラインのレイアウトを示します。V<sub>o</sub> は電源の供給電圧、i<sub>n</sub> は IC2 の動作による消費電流変動、Z は電源ラインのインピーダンスを示します。V<sub>n</sub> は電源ラインに発生する電圧で V<sub>n</sub> = i<sub>n</sub> × Z の関係を持ちます。GND パターンも同様の考え方で、GND パターン設計は「4.1.2.2 GND パターン設計」を参照してください。

(a)の電源構成は MCU までの電源ラインが長く、MCU 電源付近から IC2 の電源ラインが分岐する構成です。この場合 IC2 が動作すると MCU の供給電圧が V<sub>n</sub> のノイズを受けるため非推奨です。

(b)と(c)は回路図上は(a)と同等ですが、パターン設計が異なります。

(b)は電源の根本から電源ラインを分岐する構成で、電源と MCU の間の Z を最小化することで V<sub>n</sub> の影響を低減できます。

(c)は電源ラインの面積や線幅を増やすことで Z を最小化し、V<sub>n</sub> の影響を低減します。

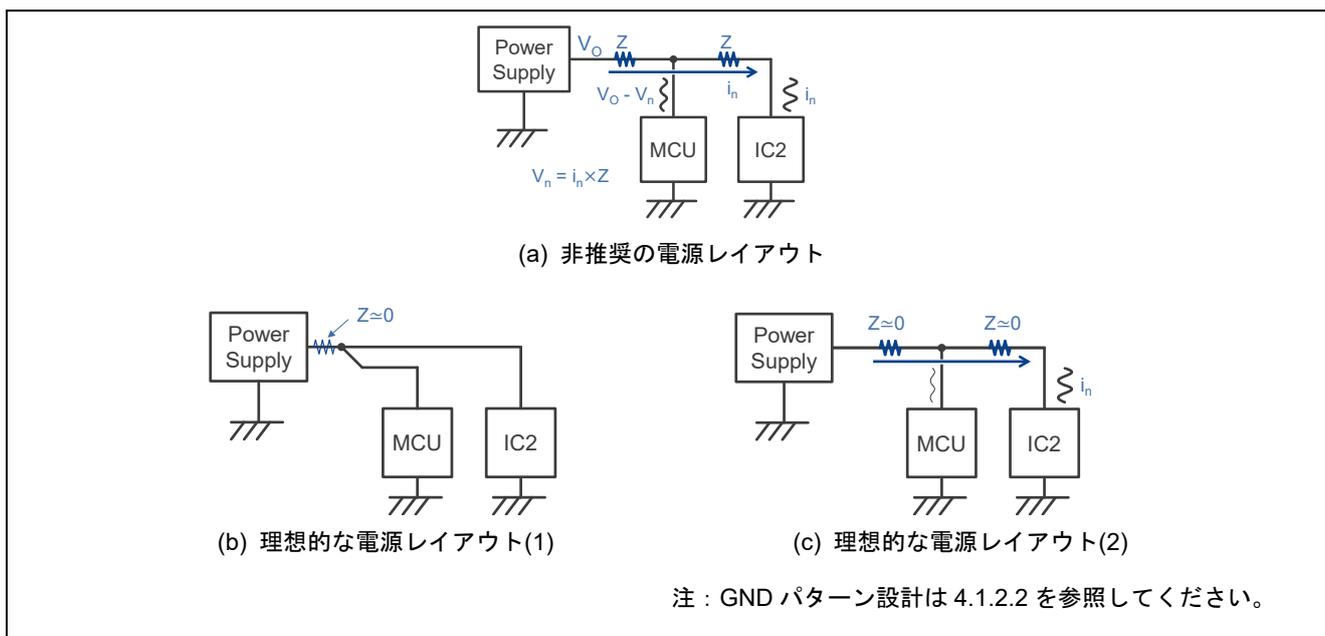


図 4-3 電源供給ラインのレイアウト

4.1.2.2 GND パターン設計

MCU やボード上デバイスの基準電圧である GND は、パターン設計によってはノイズにより電位が変動し、CTS の計測精度が低下するため注意が必要です。以下に GND パターン設計のポイントを示します。

- 空きパターンは可能な限り GND のベタパターンを配置し、面積を広くしてインピーダンスを最小化してください。
- ボード上の電流負荷が高いデバイスと MCU は距離を離し、GND パターンも分離して、GND ラインから MCU にノイズが侵入しないようにレイアウトしてください。

図 4-4 に GND ラインのレイアウトを示します。 $i_n$  は IC2 の動作による消費電流変動、 $Z$  は GND ラインのインピーダンスを示します。 $V_n$  は GND ラインに発生する電圧で  $V_n = i_n \times Z$  の関係を持ちます。

(a) の GND ラインは MCU までの距離が長く、MCU の GND ピン付近で IC2 の GND ラインが合流する構成です。この場合 IC2 が動作すると MCU の GND 電位が  $V_n$  のノイズを受けるため非推奨です。

(b) は電源の GND ピン根本で GND ラインが合流する構成です。MCU と IC2 の GND ラインを分離し、電源と MCU の間の  $Z$  を最小化することで  $V_n$  の影響を低減できます。

(c) は回路図上は (a) と同等ですが、パターン設計が異なります。(c) は GND ラインの面積や線幅を増やすことで  $Z$  を最小化し、 $V_n$  の影響を低減します。

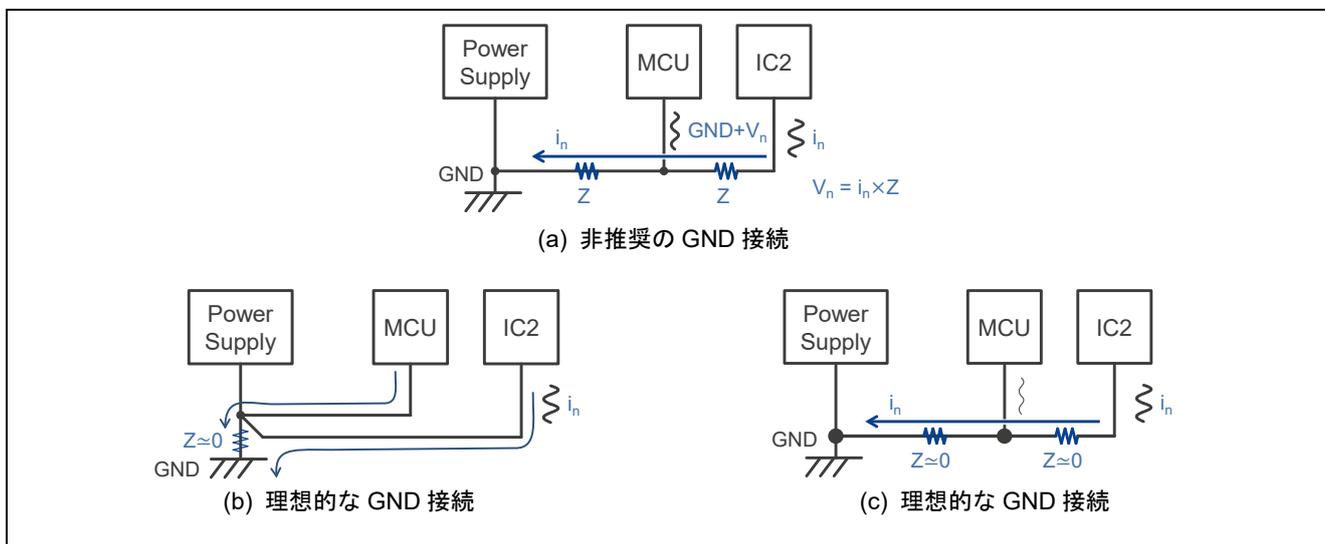


図 4-4 GND ラインのレイアウト

- TSCAP コンデンサの GND は MCU の VSS 端子と同電位になるように、MCU の VSS 端子が接続された GND ベタパターンに接続し、TSCAP コンデンサの GND と MCU の GND は分離しないでください。TSCAP コンデンサの GND と MCU の GND 間のインピーダンスが高い場合、TSCAP コンデンサの高周波ノイズ除去性能が低下し、電源ノイズや外来ノイズの影響を受けやすくなります。

4.1.3 未使用端子の処理

未使用端子をハイインピーダンス状態のまま使用すると外来ノイズの影響を受けやすくなります。未使用端子は各 MCU ファミリのハードウェアマニュアルに記載された「未使用端子の処理」を参照し、適切に処理してください。実装面積が限られプルダウン抵抗を実装できない場合は、端子を出力設定かつ Low 出力固定にしてください。

## 4.2 放射 RF のノイズ対策

### 4.2.1 TS 端子のダンピング抵抗

TS 端子に接続するダンピング抵抗と電極の寄生容量成分はローパスフィルタとして機能します。ダンピング抵抗を大きくすることでカットオフ周波数が低下し、TS 端子に侵入する放射ノイズのレベルを低減できます。ただし静電容量計測の充放電時間が長くなるとセンサドライブパルス周波数を低下させる必要があります。タッチ検出感度も低下するため注意が必要です。自己容量方式のダンピング抵抗を変更したときの感度特性は、[静電容量センサマイコン 静電容量タッチ電極デザインガイド \(R30AN0389\)](#) の「5. 自己容量方式ボタン設計と特性データ」を参照してください。

### 4.2.2 デジタル信号のノイズ

SPI や I2C などの通信、LED や音声出力の PWM 信号を扱うデジタル信号配線は放射ノイズ源となりタッチ電極回路に影響します。デジタル信号を使用する場合は以下に注意して設計してください。

- 配線のコーナーを直角（90 度）にすると鋭角部分からのノイズ放射が大きくなります。ノイズ放射を小さくするために配線のコーナーは 45 度以下、または曲線にしてください。
- デジタル信号レベルが変化した際のオーバーシュートやアンダーシュートは高周波ノイズとして放射されます。デジタル信号ラインの出力側にダンピング抵抗を配置しオーバーシュート、アンダーシュートを抑制してください。またはフェライトビーズを配置してください。
- デジタル信号配線とタッチ電極回路の配線は隣接しないように配置してください。並走してしまう場合は可能な限り距離を離し、デジタル配線には GND シールドを配置してください。
- MCU 端子で高消費電流のデバイスを動作させる場合はトランジスタや FET を使用してください。

### 4.2.3 マルチ周波数計測

CTS U2 を搭載した MCU を使用している場合はマルチ周波数計測を使用してください。詳細は「3.3.1 マルチ周波数計測」を参照してください。

### 4.3 伝導ノイズ対策

伝導ノイズ耐性は MCU ボード設計よりもシステム電源設計が重要です。まずはボード実装デバイスにノイズの少ない電圧を供給できる電源設計を行ってください。電源設計のポイントは「4.1.2 電源設計」を参照してください。本章では伝導ノイズ耐性向上のための MCU ボード設計時に考慮すべき電源のノイズ対策と CTSU 機能について説明します。

#### 4.3.1 コモンモードフィルタ

電源ケーブルからボードに侵入するノイズを低減するにはコモンモードフィルタ（コモンモードチョーク、フェライトコア）を配置、または取り付けてください。ノイズ試験等によりシステムの干渉周波数を調べ、低減させたいノイズ帯域に対してインピーダンスが高いデバイスを選定してください。フィルタの種類により取り付け位置が異なるためそれぞれの項目を参照してください。フィルタは外来ノイズをボード内に拡散させないように配置箇所を考慮する必要があります。図 4-5 にコモンモードフィルタの配置例を示します。

- コモンモードチョーク

コモンモードチョークはボード上でノイズ対策する場合に使用します。そのためボードやシステム設計時にあらかじめ組み込んでおく必要があります。コモンモードチョークを使用する場合、ボード電源の接続ポイントの直後に最短配線で配置してください。例としてケーブルとボードをコネクタで接続する場合、ボード側コネクタの直後にフィルタを配置することでケーブルからボードに侵入するノイズがボード上に拡散することを防ぎます。

- フェライトコア

フェライトコアはケーブルに伝搬するノイズを低減させる場合に使用します。システムアセンブリ後にノイズの問題が発生した場合はクランプタイプのフェライトコアを使用するとボードやシステム設計を変更せずにノイズ対策ができます。例としてケーブルとボードをコネクタで接続する場合、ボード側のコネクタ直前にフィルタを配置することでボードに侵入するノイズを最小限にできます。

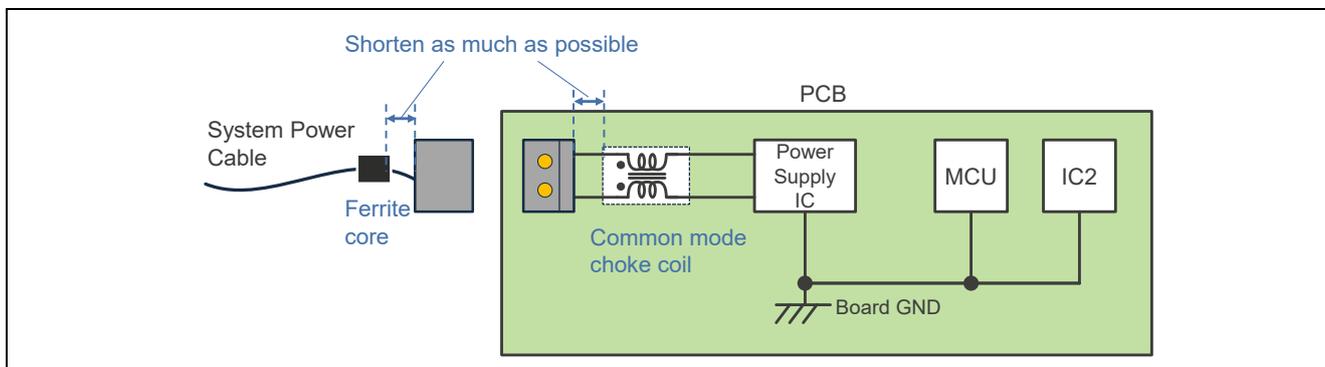


図 4-5 コモンモードフィルタの配置例

#### 4.3.2 コンデンサの配置

電源および信号ケーブルからボードに侵入する電源ノイズ、およびリップルノイズを低減するには MCU の電源ライン、または端子付近にデカップリングコンデンサ、バルクコンデンサを適切に設計および配置してください。

- デカップリングコンデンサ

MCU 自身の消費電流による VCC または V<sub>DD</sub> の電源ピン-VSS 間の電圧降下を低減し、CTSU の計測を安定させます。ご使用になる MCU のユーザーズマニュアルに記載された推奨容量を電源ピンと VSS ピン近傍に配置してください。またご使用になる MCU ファミリによりハードウェアデザインガイドが用意されている場合はデザインガイドに従ってパターン設計してください。

- バルクコンデンサ

MCU の電圧供給源のリップルを平滑化し MCU の電源ピン-VSS 間の電圧を安定させ CTSU の計測も安定させます。コンデンサの容量は電源設計により異なるため、発振や電圧降下が発生しないよう適切な値を配置してください。

4.3.3 マルチ周波数計測

伝導ノイズ耐性向上には CTSU2 の機能であるマルチ周波数計測が効果的です。伝導ノイズ耐性を考慮する必要がある場合は、CTSU2 を搭載した MCU を選定し、マルチ周波数計測機能を使用してください。詳細は「3.3.1 マルチ周波数計測」を参照してください。

4.3.4 GND シールドと電極間距離の考慮

図 4-6 に電極シールドの伝導ノイズ追加パスによるノイズ抑制イメージを示します。電極周囲に GND シールドを配置、および電極周囲のシールドを電極に近づけることで指とシールドの容量結合が強くなり、ノイズ成分 ( $V_{NOISE}$ ) が B-GND に逃げるため CTSU の計測電流変動を低減できます。シールドを電極に近づけると  $C_p$  が大きくなりタッチ検出感度も低下するため注意が必要です。シールドと電極間の距離を変化させたときの感度特性は、[静電容量センサマイコン 静電容量タッチ電極デザインガイド \(R30AN0389\)](#) の「5. 自己容量方式ボタン設計と特性データ」を参照してください。

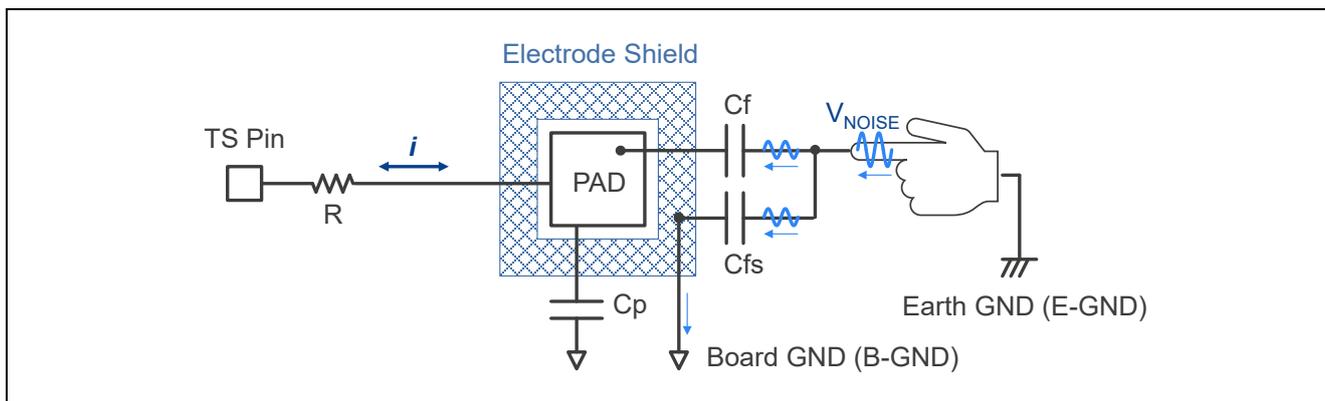


図 4-6 電極シールドの伝導ノイズ追加パスによるノイズ抑制イメージ

5. ソフトウェアフィルタ

CTSU ドライバは標準フィルタとして IIR 移動平均フィルタを実装しており、ほとんどの場合標準フィルタで十分な SNR と応答性を得ることができます。しかし、ユーザシステムによっては、より強力なノイズ低減処理が必要となることがあります。

図 5-1 にユーザフィルタ処理追加時のデータフローを示します。ユーザフィルタは CTSU ドライバと TOUCH モジュールの間に配置して処理を行うことができます。詳細なプロジェクトファイルへの組み込み方法、ソフトウェアフィルタのサンプルコード、および使用例プロジェクトファイルは下記アプリケーションノートを参照してください。

[RA ファミリ 静電容量タッチ ソフトウェアフィルタサンプルプログラム \(R30AN0427\)](#)

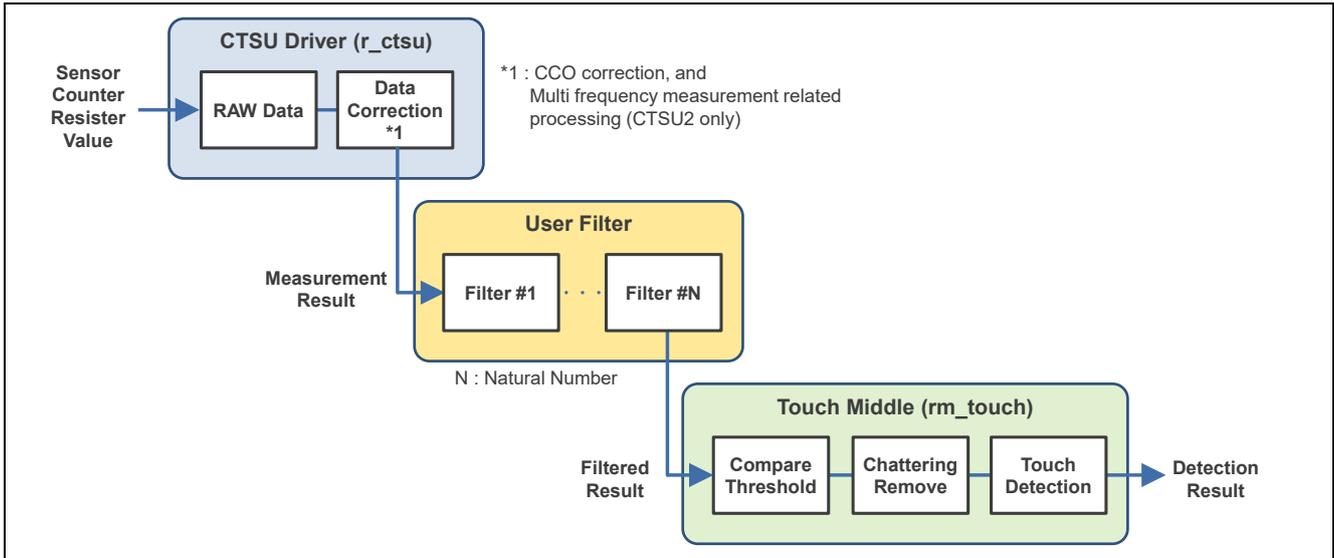


図 5-1 ユーザフィルタ処理追加時のデータフロー

本章では EMC 規格ごとに有効なフィルタを紹介します。

表 5-1 EMC 規格と対応ソフトウェアフィルタ

EMC 規格	想定ノイズ	対応ソフトウェアフィルタ
IEC61000-4-3 放射イミュニティ、	ランダムノイズ	IIR フィルタ
IEC61000-4-6 伝導イミュニティ	周期ノイズ	FIR フィルタ

5.1 IIR フィルタ

IIR フィルタ (Infinite Impulse Response フィルタ) は省メモリ、小演算負荷で、ローパワーシステムやボタン個数が多いアプリケーションに最適です。ローパスフィルタとして使用することで高周波ノイズを低減できます。但し、カットオフ周波数を低くするほど整定時間が長くなり、ON/OFF 判定処理が遅延するため注意が必要です。

単極 1 次 IIR フィルタは、a, b を係数、 $x_n$  を入力値、 $y_n$  を出力値、 $y_{n-1}$  を前回出力値として、次式で計算します。

$$y_n = ax_n + by_{n-1}$$

ローパスフィルタとして使用する場合、係数 a と b はサンプリング周波数  $f_s$ 、カットオフ周波数  $f_c$  とすると次式で求めることができます。

$$b = e^{-\frac{2\pi f_c}{f_s}}, \quad a = 1 - b$$

## 5.2 FIR フィルタ

FIR フィルタ (Finite Impulse Response フィルタ) は演算誤差による精度劣化が小さく安定度の高いフィルタです。係数によりローパスフィルタやバンドパスフィルタとして使用することで、周期ノイズやランダムノイズを低減して SNR が改善します。但し、過去の一定期間のサンプルを保持し演算するため、フィルタタップ長に比例してメモリ使用量や演算負荷が増加します。

FIR フィルタは、フィルタタップ長を  $L$ 、 $h_0 \sim h_{L-1}$  を係数、 $x_n$  を入力値、 $x_{n-i}$  を  $i$  サンプル前の入力値、 $y_n$  を出力値とすると、次式で計算します。

$$y_n = \sum_{i=0}^{L-1} h_i \cdot x_{n-i}$$

## 5.3 使用例

IIR フィルタ、FIR フィルタを使用したノイズ除去例を以下に示します。表 5-2 にフィルタ条件を、図 5-2 にランダムノイズ除去例を示します。

表 5-2 フィルタ使用例条件

フィルタ形式	条件 1	条件 2	補足
単極 1 次 IIR	$b=0.5$	$b=0.75$	
FIR	$L=4$ $h_0 \sim h_{L-1}=0.25$	$L=8$ $h_0 \sim h_{L-1}=0.125$	単純移動平均として使用

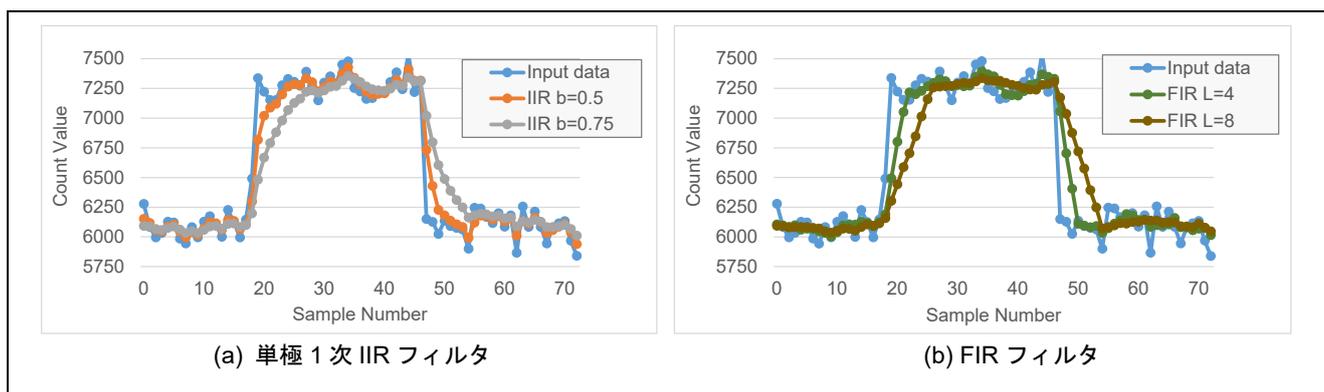


図 5-2 ランダムノイズノイズ除去例

## 5.4 計測周期の注意事項

ソフトウェアフィルタは計測周期の精度により周波数特性が変化し、計測周期のズレやばらつきで期待した特性が得られない場合があります。フィルタ特性を優先する場合はメインクロックに高速オンチップオシレータ (HOCO) や外付け水晶発振子を使用してください。またタッチ計測実行周期はハードウェアタイマで管理することを推奨します。

用語集

用語	説明
CTSUS	Capacitive Touch Sensing Unit の略称です。CTSUS1 と CTSUS2 の総称としても使用しています。
CTSUS1	第2世代の CTSUS IP の総称で、CTSUS2 と区別するための表記です。
CTSUS2	第3世代の CTSUS IP の総称です。
CTSUS ドライバ	ルネサスソフトウェアパッケージに内包された CTSUS のドライバソフトウェアです。
CTSUS モジュール	スマート・コンフィグレータで組み込むことができる CTSUS ドライバ ソフトウェアの単位です。
TOUCH ミドルウェア	ルネサスソフトウェアパッケージに内包された CTSUS を使用したタッチ検出処理のミドルウェアです。
TOUCH モジュール	スマート・コンフィグレータで組み込むことができる TOUCH ミドルウェア ソフトウェアの単位です。
r_ctsu モジュール	スマート・コンフィグレータで表示される CTSUS ドライバの名称です。
rm_touch モジュール	スマート・コンフィグレータで表示される TOUCH モジュールの名称です。
CCO	CCO (Current Control oscillator) とは静電容量タッチセンサで使用する電流制御発振器です。ドキュメントによっては ICO と表記しています。
ICO	CCO と同じです。
TSCAP	CTSUS の内部電圧を安定させるためのコンデンサです。
ダンピング抵抗	外来ノイズからの端子破壊やノイズの影響を軽減するための抵抗です。詳細は静電容量タッチ電極デザインガイド(R30AN0389)を参照して下さい。
VDC	VDC(voltage down converter)は CTSUS に内蔵している静電容量センサ計測用の電源回路です。
マルチ周波数計測	周波数の異なる複数のセンサユニットクロックを使用して計測する機能であり、マルチクロック計測機能を指します。
センサドライブパルス	スイッチトキャパシタを駆動する信号です。
同期ノイズ	センサドライブパルスと一致する周波数のノイズです。
EUT	Equipment Under Test の略号です。試験対象の装置を意味します。
LDO	Low Dropout Regulator の略号です。
PSRR	Power Supply Rejection Ration の略号です。
FSP	Flexible Software Package の略号です。
FIT	Firmware Integration Technology の略号です。
SIS	Software Integration System の略号です。

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	May.31.2023	-	新規発行
2.00	Dec.25.2023	-	IEC61000-4-6 に対応
		6	コモンモードノイズの影響を追記
		7	表 2-5 伝導 RF ノイズ対策を追記
		9	3.1 文章を修正、図 3-1 を修正 3.2 文章を修正
		10	3.3.1 説明文を修正、図 3-4 を修正 マルチ周波数計測の設定変更方法を削除 マルチ周波数計測の干渉周波数説明および図 3-5 を追加
		11	3.3.2 参考資料を追記
		14	4.1.2.2 TSCAP コンデンサの GND 接続の注意事項を追加
		15	4.2.2 配線のコーナー設計の注意事項を追加
		16	4.3 伝導ノイズ対策を追加
18	5 章 全体的に修正		

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

### 5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

### 7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違くと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
  2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
  3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
  4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
  5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
  6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。  
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等  
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
  7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
  8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
  9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
  10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
  11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
  12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
  13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
  14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。